

福邦證券股份有限公司等包銷昇陽國際半導體股份有限公司 初次上市前公開承銷之普通股股票銷售辦法公告 股票代號：8028

(本案公開申購係預扣價款，並適用掛牌後首五交易日無漲跌幅限制之規定，投資人申購前應審慎評估)
(本案投標人需繳交投標保證金，如得標後不履行繳款義務者，除喪失得標資格外，證券承銷商就投標保證金應沒入之)

福邦證券股份有限公司等共同辦理昇陽國際半導體股份有限公司（以下簡稱昇陽半公司或該公司）普通股股票初次上市承銷案（以下簡稱本次承銷案）公開銷售之總股數為 13,243 仟股對外辦理公開銷售，其中 10,595 仟股以競價拍賣方式為之，業已於 107 年 6 月 26 日完成競價拍賣作業（開標日），2,648 仟股則以公開申購配售辦理。

茲將銷售辦法公告於後：

一、承銷商名稱、地址、總承銷數量、證券承銷商採競價拍賣、公開申購配售及過額配售數量：

股數：仟股

承銷商名稱	地址	過額配售股數	競價拍賣股數	公開申購股數	總承銷股數
福邦證券股份有限公司	台北市忠孝西路一段 6 號 7 樓	0 仟股	10,595 仟股	2,298 仟股	12,893 仟股
元大證券股份有限公司	台北市敦化南路一段 66 號 11 樓	0 仟股	0 仟股	100 仟股	100 仟股
群益金鼎證券股份有限公司	台北市松仁路 101 號 15 樓	0 仟股	0 仟股	100 仟股	100 仟股
玉山綜合證券股份有限公司	台北市民生東路三段 158 號 6 樓	0 仟股	0 仟股	50 仟股	50 仟股
臺灣土地銀行股份有限公司	台北市延平南路 81 號	0 仟股	0 仟股	50 仟股	50 仟股
富邦綜合證券股份有限公司	台北市敦化南路一段 111 號 9 樓	0 仟股	0 仟股	50 仟股	50 仟股
合 計		0 仟股	10,595 仟股	2,648 仟股	13,243 仟股

二、承銷價格：每股新台幣 24.6 元整（每股面額新台幣壹拾元整）。

三、本案適用掛牌後首五交易日無漲跌幅限制之規定，投資人應注意交易之風險。

四、初次上市承銷案件，主辦承銷商執行過額配售及價格穩定措施之相關資訊及發行公司股東自願送存集保股份佔上市掛牌資本額之比例及自願送存集保期間：

(一)依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」之規定，主辦證券商已與昇陽半公司簽定「過額配售協議書」，惟實際過額配售股數為 0 仟股。

(二)特定股東限制：依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」之規定，除依規定應提出強制集保股份外，由昇陽半公司協調股東提出其所持有之已發行普通股股份，於掛牌三個月內自願送存臺灣集中保管結算所股份有限公司集保並不得賣出，以維持承銷價格穩定。該公司強制集保股數合計 26,510,911 股，佔申請上市時發行股份總額 116,828,000 股之 22.69%或佔掛牌股數 132,408,000 股之 20.02%，另強制集保加計自願集保股數合計 42,987,607 股，佔申請上市時發行股份總額 116,828,000 股之 36.80%或佔掛牌股數 132,408,000 股之 32.47%。

五、初次上市承銷案件，是否因公開申購配售之申購狀況而調整詢價團購、公開申購配售數量之情事者，應予以揭露：不適用。

六、公開申購及過額配售投資人資格及事前應辦事項：

(一)公開申購投資人資格：

1. 申購人應為中華民國國民。
2. 申購人應於往來證券經紀商開立交易戶、款項劃撥銀行帳戶及集中保管帳戶。
3. 申購人應洽往來證券經紀商辦理與指定之銀行簽訂委託書，同意銀行未來申購截止日止，自動執行扣繳申購處理費二十元、認購價款、中籤通知郵寄工本費五十元之手續。

(二)如有辦理過額配售者，資格同本公告第六條(一)公開申購投資人資格辦理。

七、競價拍賣、公開申購及過額配售之數量限制：

(一)競價拍賣數量：競價拍賣最低每標單位為 2 張(仟股)，每一投標單最高投標數量不超過 1,324 張(仟股)，每一投標人最高得標數量不得超過 1,324 張(仟股)，投標數量以 1 張(仟股)之整倍數為投標單位。

(二)公開申購數量：每壹銷售單位為 1 仟股，每人限購 1 單位(若超過壹申購單位，即全數取消申購資格)。

(三)過額配售數量：無

(四)承銷商於辦理配售作業時，應依據「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」辦理。

八、申購期間、申購手續及申購時應注意事項：

(一)申購期間自 107 年 6 月 28 日起至 107 年 7 月 2 日止；申購處理費、中籤通知郵寄工本費及申購價款繳存往來銀行截止日為 107 年 7 月 2 日；申購處理費、中籤通知郵寄工本費及申購價款扣繳日為 107 年 7 月 3 日（扣繳時點以銀行實際作業為準）。

(二)申購方式：於申購期間內之每一營業日上午九時至下午二時，以下列方式申購(除申購截止日外，申購人於申購期間內當日下午 2 時後始完成委託者，視為次一營業日之申購委託)。

1. 電話申購：投資人可以電話向往來經紀商業務人員下單申購並由其代填申購，故雖未親自填寫，但視同同意申購委託書所載各款要項。
2. 當面或網際網路申購：投資人應確實填寫申購委託書各項資料並簽名或蓋章，至往來經紀商當面向業務人員或於申購期間截止日前以網際網路申購，惟採網際網路時，申購者需自負其失誤風險，故申購人宜於網際網路申購後電話洽收件經紀商業務人員，以確保經紀商收到申購委託書。

(三)申購人向證券經紀商投件申購後，申購委託書不得撤回或更改。

(四)每件公開申購抽籤案件，每位申購人僅能向一家證券經紀商辦理申購，且以申購一件為限。重複申購者將被列為不合格件，取消申購資格。

(五)申購人申購時，需確認申購截止日銀行存款餘額應有申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費之合計金額供銀行執行扣款。如有數個有價證券承銷案於同一天截止申購，當申購人投件參與其中一個以上案件時，銀行存款之扣款應以所申購各案有價證券處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費之合計總額為準，否則全數為不合格件。

(六)為便於申購人查閱投件是否已被接受為合格件，收件經紀商於申購期間，每日將截至前一日止之初步合格及不合格申購資料(此時尚

未驗證重複件，亦尚未執行款項扣繳)備置於營業廳，以供申購人查閱。

- (七)申購人申購後，往來銀行於扣繳日 107 年 7 月 3 日將辦理申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費扣繳事宜(扣繳時點以銀行實際作業為準)。如申購人此時銀行存款不足申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費三項總計之金額，將視為不合格件。
- (八)申購人之申購件一旦被列為不合格件，則將取消申購資格，證券經紀商於公開抽籤日次一營業日上午十點前(107 年 7 月 5 日)，併同未中籤之申購人之退款作業，退還中籤通知郵寄工本費及申購有價證券價款(均不加計利息)，惟申購處理費不予退回。
- (九)申購人銀行存款不足同時支應投標保證金、投標處理費、得標價款、得標手續費、申購處理費、申購認購價款、中籤通知郵寄工本費及交易市場之交割價款時，應以交割價款為優先，次為得標價款及得標手續費，再為申購處理費、申購認購價款及中籤通知郵寄工本費，最後為投標保證金及投標處理費。

九、公開申購銷售處理方式及抽籤時間：

- (一)相關作業請參考「中華民國證券商業同業公會證券商辦理公開申購配售作業處理程序」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」。
- (二)證交所應於抽籤前，將銀行存款不足無法如期扣繳申購處理費、申購價款、中籤通知郵寄工本費之合計金額及重複申購之資料予以剔除，並應於申購截止日之次一營業日完成上述合格件及不合格件之篩選，重複申購者已扣繳之處理費不予退還，並由承銷商於承銷期間截止後一週內以掛號函件通知申購人。
- (三)如申購數量超過銷售數量時，則於 107 年 7 月 4 日上午九時起在臺灣證券交易所電腦抽籤室(台北市信義路五段七號十樓)，以公開方式就合格件辦理電腦抽籤作業抽出中籤人，其方式依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷及再行銷售有價證券處理辦法」辦理，並由證交所邀請發行公司代表出席監督。

十、申購人經中籤後不能放棄認購及要求退還價款，申購前應審慎評估。

十一、通知及(扣)繳交價款日期與方式：

(一)競價拍賣部分：

1.得標人之得標價款及得標手續費繳存往來銀行截止日為 107 年 6 月 28 日止，得標人應繳足下列款項：

(1)得標價款：得標人應依其得標價款認購之，應繳之得標價款，應扣除已扣繳之投標保證金後為之。

(2)得標手續費：

依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第十二條規定，承銷商得向得標人收取得標手續費。本次承銷案件得標人每一得標單應繳交得標價款之 4.5%之得標手續費，並併同得標價款於銀行繳款截止日(107 年 6 月 28 日)前存入往來銀行。

每一得標單之得標手續費：每股得標價格×得標股數×4.5%。

(3)得標人得標價款及得標手續費扣繳日：107 年 6 月 29 日(依銀行實際之扣款作業為準)。

2.得標人未如期履行繳款義務時，除喪失得標資格外，投標保證金應由主辦承銷商沒入之，並依該得標人得標價款自行認購。

3.如有數個有價證券承銷案於同一天截止繳交得標價款及得標手續費，當投資人投標參與其中一個以上案件，或就同一競價拍賣案件有多筆得標單時，銀行存款之扣款應以已繳保證金較高者優先扣款，如金額相同者，以得標應繳價款及得標手續費合計總額較高者優先扣款，如金額相同者，以投標單輸入時間先後順序扣款。

4.未得標及不合格件保證金退款作業：經紀商業於開標日次一營業日(107 年 6 月 27 日)上午十點前，依證交所電腦資料，指示往來銀行將未得標(包括單一投標單部份未得標)及不合格件之保證金不加計利息予以退回，惟投標處理費不予退回。

(二)公開申購部份：申購處理費、中籤通知郵寄工本費及申購價款扣繳日為 107 年 7 月 3 日(扣繳時點以銀行實際作業為準)。

(三)實際承銷價格(公開申購)訂定之日期為 107 年 6 月 26 日，請於當日上午十時自行上網至臺灣證券交易所網(<http://www.twse.com.tw>)免費查詢。

(四)如有辦理過額配售時，係採公開申購方式，並依中華民國證券商業同業公會「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」及「證券商辦理公開申購配售作業處理程序」辦理。

十二、未中籤人或不合格件之退款作業：對於未中籤人之退款作業，將於公開抽籤次一營業日(107 年 7 月 5 日)，依證交所電腦資料，將中籤通知郵寄工本費及認購價款退還未中籤申購人(均不加計利息)，惟申購處理費不予退回。

十三、公開申購之中籤名冊及競價拍賣得標名單之查詢管道：

(一)公開申購：

1.可參加公開抽籤之合格清冊，將併同不合格清冊，於公開抽籤日，備置於收件經紀商(限所受申購部分)，台灣證券交易所股份有限公司及主辦承銷商營業處所，以供申購人查閱。

2.由承銷商於公開抽籤日次一營業日以限時掛號寄發中籤通知書及公開說明書等。

3.申購人可以向原投標證券經紀商查閱中籤資料，亦可以透過台灣集中保管結算所股份有限公司電話語音系統查詢是否中籤，但使用此系統前，申購人應先向證券經紀商申請查詢密碼，相關查詢事宜如后：

(1)當地電話號碼七碼或八碼地區(含金門)，請撥 412-1111 或 412-6666，撥通後再輸入服務代碼 111#

(2)當地電話號碼六碼地區請撥 41-1111 或 41-6666，撥通後再輸入服務代碼 111#

(3)中籤通知郵寄工本費每件 50 元整。

(二)競價拍賣：開標日後，投標人可於「承銷商有價證券競價拍賣系統」或向開戶證券經紀商查詢，亦可以透過臺灣集中保管結算所股份有限公司電話語音系統查詢是否得標，但使用此系統前，得標人應先向證券經紀商申請查詢密碼，相關查詢事宜如本公告十三、(一)3。

十四、有價證券發放日期、方式與特別注意事項：

(一)昇陽半公司於股款募集完成後，通知集保結算所於 107 年 7 月 10 日將股票直接劃撥至認購人指定之集保帳戶，並於當日上市(實際上市日期以發行公司及證券交易所公告為準)。

(二)認購人帳號有誤或其他原因致無法以劃撥方式交付時，認購人須立即與所承購之承銷商辦理後續相關事宜。

十五、有價證券預定上市日期：107 年 7 月 10 日。(實際上市日期以發行公司及證券交易所公告為準)。

十六、投資人應詳閱本銷售辦法、公開說明書及相關財務資料，並對本普通股股票之投資風險自行審慎評估，昇陽半公司及各證券承銷商均未對本普通股股票上市後價格為任何聲明、保證或干涉，其相關風險及報酬均由投資人自行負擔。如欲知其他財務資料可參閱公開資訊觀測站(<http://www.mops.twse.com.tw>)或發行公司網址：<http://www.psi.com.tw>)。

十七、公開說明書之分送、揭露及取閱地點：

(一)有關昇陽半公司之財務及營運情形已詳載於公開說明書，請至辦理股票過戶機構永豐金證券股份有限公司股務代理部(台北市博愛路 17 號 3 樓)及各承銷商之營業處所索取，或上網至公開資訊觀測站(<http://www.mops.twse.com.tw>)及主、協辦承銷商網站免費查詢，網址如下：

福邦證券股份有限公司 <http://www.gfortune.com.tw>

元大證券股份有限公司 <http://www.yuanta.com.tw>

群益金鼎證券股份有限公司 <https://www.capital.com.tw>

玉山綜合證券股份有限公司 <https://www.esunsec.com.tw>

臺灣土地銀行股份有限公司 <http://stock.landbank.com.tw>

富邦綜合證券股份有限公司 <https://www.fubon.com>

- (二)競價拍賣開標後，承銷商應將「得標通知書」及「公開說明書」以限時掛號寄予得標投資人；另應於公開申購結束後，將「公開說明書」、「中籤通知書」以限時掛號寄發中籤人。

十八、會計師最近三年度財務資料之查核簽證意見：

年度	會計師事務所	會計師姓名	簽證意見
104 年	資誠聯合會計師事務所	曾國華、李典易	無保留意見
105 年	資誠聯合會計師事務所	曾國華、李典易	無保留意見
106 年	資誠聯合會計師事務所	李典易、謝智政	無保留意見
107 年第一季	資誠聯合會計師事務所	李典易、謝智政	無保留意見

十九、財務報告如有不實，應由發行公司及簽證會計師依法負責。

二十、特別注意事項：

- (一)認購人於認購後、有價證券發放前死亡者，其繼承人領取時，應憑原認購人死亡證明書、繼承人之國民身分證正本(未滿十四歲之未成年人，得以戶口名簿正本及法定代理人國民身分證正本代之)、繼承系統表、戶籍謄本(全戶及分戶)、繼承人印鑑證明(未成年人應加法定代理人印鑑證明)、遺產稅證明書，繼承人中有拋棄繼承者應另附經法院備查之有價證券繼承拋棄同意書及其他有關文件辦理。
- (二)申購人有左列各款情事之一者，經紀商不得受託申購，已受理者應予剔除：
- 1.於委託申購之經紀商未開立交易戶、款項劃撥銀行帳戶或集中保管帳戶者。
 - 2.未與經紀商指定之往來銀行就公開申購相關款項扣繳事宜簽訂委託契約書。
 - 3.未於規定期限內申購者。
 - 4.申購委託書應填寫之各項資料未經填妥或資料不實者。
 - 5.申購委託書未經簽名或蓋章者，惟以電話或網際網路委託者不在此限。
 - 6.申購人款項劃撥銀行帳戶之存款餘額，低於所申購有價證券處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費之合計金額者。
 - 7.利用或冒用他人名義申購者。
- (三)本次參與有價證券承銷申購之人，於中籤後發現有違反前述第(一)、(二)項之規定，應取消其認購資格者，其已扣繳認購有價證券款項應予退還；但已扣繳之申購處理費及中籤通知郵寄工本費不予退還。前項經取消認購資格之認購人及經取消認購資格之繼承人，欲要求退還已繳款項時，應憑認購人或其繼承人身分證正本(法人為營利事業登記證影本，未滿十四歲之未成年人，得以戶口名簿正本及法定代理人身分證正本代之)，洽原投件證券經紀商辦理。
- (四)申購人可以影印或自行印製規格尺寸相當之申購委託書。
- (五)申購人不得冒用或利用他人名義或偽編國民身分證字號參與。證券商經發現有冒用、利用他人名義或偽編國民身分證字號參與有價證券申購者，應取消其參與申購資格，處理費用不予退還；已認購者取消其認購資格；其已繳款項，不予退還。
- (六)若於中籤後發現有中籤人未開立或事後註銷交易戶、款項劃撥銀行帳戶或集中保管帳戶情事，致後續作業無法執行者，應取消其其中籤資格。
- (七)證券交易市場如因天然災害或其他原因致集中交易市場休市時，有關申購截止日、公開抽籤日、處理費、中籤通知郵寄工本費或價款之繳存、扣繳、解交、匯款等作業及其後續作業順延至次一營業日辦理；有關投標截止日、開標日、投標處理費、投標保證金、得標手續費、價款之繳存、扣繳、解交、匯款等作業，其後續作業一律順延至次一營業日辦理；另如係部份縣(市)停止上班，考量天災係不可抗力之事由，無法歸責證券商，投資人仍應注意相關之風險，如投標保證金及投標處理費扣款日遇部分縣(市)停止上班但集中市場未休市時，投標保證金及投標處理費之扣繳日及其後續之開標日、未得標或不合格件保證金退款日、得標剩餘款項及得標手續費繳存往來銀行截止日及扣繳日、經紀商價款解交日等均順延一營業日辦理。

二十一、該股票奉准上市以後之價格，應由證券市場買賣雙方供需情況決定，承銷商及發行公司不予干涉。

二十二、承銷價格決定方式(如附件一)。

二十三、律師法律意見書要旨：(如附件二)。

二十四、證券承銷商評估報告總結意見(如附件三)。

二十五、金融監督管理委員會或中華民國證券商業同業公會規定應行揭露事項：無。

二十六、其他為保護公益及投資人應補充揭露事項：詳見公開說明書。

【附件一】股票承銷價格計算書

一、承銷總股數說明

- (一)昇陽國際半導體股份有限公司(以下簡稱昇陽半導體或該公司)股票初次申請上市時之實收資本額為新台幣 1,168,280 仟元，每股面額新台幣 10 元整，已發行股數為 116,828 仟股。該公司已於 107 年 4 月 25 日董事會通過新股承銷案，擬辦理現金增資發行新股 15,580 仟股為上市前公開承銷作業，股票上市掛牌時之實收資本額為新台幣 1,324,080 仟元，發行股數為 132,408 仟股。
- (二)依據「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第十一條及「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則補充規定」第十七條之一規定，公開發行公司初次申請股票上市時，至少應提出擬上市股份總額百分之十之股份，全數以現金增資發行新股之方式，於扣除依公司法相關法令規定保留供公司員工承購之股數後，委託證券承銷商辦理上市前公開銷售。該公司依擬上市股份總額之 10%計算應提出公開承銷股數，辦理現金增資發行新股 15,580 仟股，並依「公司法」第二百六十七條之規定，保留發行總股數之 15%，計 2,337 仟股供員工認購，其餘 13,243 仟股則依「證券交易法」第二十八條之一規定，並業經 106 年 5 月 25 日股東會決議通過由原股東全數放棄認購，排除「公司法」第二百六十七條第三項之適用，全數委託證券承銷商辦理上市前公開承銷。
- (三)依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」第二條第一項第一款之規定，主辦承銷商應要求發行公司協調其股東就當次依法令規定委託證券商辦理公開承銷股數 15%之額度(上限)，提供已發行普通股股票供主辦證券承銷商辦理過額配售，惟主辦承銷商得依市場需求決定過額配售數量。該公司業經 106 年 11 月 28 日董事會決議通過與證券承銷商簽訂過額配售協議，將協調股東提出委託證券承銷商辦理公開承銷股數 15%之額度內，上限計 1,986 仟股供證券承銷商辦理過額配售，惟證券承銷商得依市場需求決定過額配售數量。
- (四)該公司截至 107 年 3 月 27 日止，記名股東人數共計 8,363 人，其中公司內部人及該等內部人持股逾百分之五十之法人以外之記名股東人數 8,317 人，且其所持股份總額合計 91,640,880 股，占目前發行股份總額 78.44%，業符合「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第四條有關記名股東人數一千人以上且所持有股份總額合計占發行股份總額百分之二十以上或滿一千萬股之股權分散標準。

二、承銷價格說明

(一)承銷價格訂定所採用的方法、原則或計算方式及與適用國際慣用之市場法、成本法及收益法之比較

本證券承銷商依一般市場承銷價格訂定方式作為該公司辦理股票公開承銷之參考價格訂定依據，主要係參考市場法、成本法及收益法等方式。股票價值評估之各種方法皆有其優缺點，評估之結果亦有所差異，市場法如本益比法、股價淨值比法，係透過已公開資訊與整個市場、產業性質相近之同業及被評價公司歷史軌跡進行比較，以作為評量企業價值之依據，再根據被評量公司本身異於同業之部分作折溢價調整；成本法主要係以淨值法作為公司價值評定依據，其方法係透過帳面之歷史成本資料，資料容易取得，惟未考量公司未來經營成效；收益法係以未來現金流量作為公司價值評定基礎，可反映企業永續經營之價值、考量企業成長性及風

險，但計算變數過多，投資者對現金流觀念不易了解，且預測期間較長。本證券承銷商依一般市場承銷價格訂定方式，主要係參考市場法、成本法、收益法及該公司最近一個月興櫃市場之平均成交價方式，以作為該公司辦理股票公開承銷之參考價格訂定依據，復參酌該公司最近三年度及最近期之經營績效、獲利情形以及所處產業未來前景、發行市場環境及同業市場狀況等因素後，由本證券承銷商與該公司共同議定本次承銷價格。

該公司主要從事半導體晶圓代工服務及鋰電池產品之研發、製造及銷售。其中，半導體晶圓代工服務係提供晶圓再生、晶圓薄化及微機電中段製程代工服務，終端產品主要應用於半導體晶圓代工、消費型電子產品及汽車等電子元件；鋰電池產品則包含電池芯及電池組，主要應用於儲能及動力領域。綜觀目前國內已上市、上櫃及興櫃之公司中，並無完全與該公司從事相同業務內容之公司，故考量產業屬性、業務內容、營運模式及應用領域等因素，選取辛耘企業股份有限公司(證券代號 3583，以下簡稱辛耘公司)、中國砂輪企業股份有限公司(證券代號 1560，以下簡稱中砂公司)、精材科技股份有限公司(證券代號 3374，以下簡稱精材公司)及台灣茂矽電子股份有限公司(證券代號 2342，以下簡稱茂矽公司)作為採樣同業公司。其中，辛耘公司主要從事半導體、LED、LCD、封裝測試與太陽能設備之製造、代理銷售及提供晶圓再生服務，而中砂公司主要從事生產及銷售砂輪、鑽石碟等研磨工具及提供晶圓再生服務，辛耘公司及中砂公司之晶圓再生服務與該公司所從事之晶圓再生業務相同；精材公司係晶圓級 IC 封裝廠商，主要服務包括晶圓級尺寸封裝服務與晶圓級後護層封裝服務，亦有晶圓背面研磨和金屬鍍膜製程(BGBM)及微機電中段製程代工服務與該公司晶圓薄化及微機電中段之製程，且應用領域亦為消費型電子產品與該公司雷同；茂矽公司係從事晶圓製造業務，亦有提供晶圓背面研磨和金屬鍍膜製程與該公司晶圓薄化製程代工服務相同，且應用領域亦與該公司消費型電子產品相同。

1. 市場法

(1) 本益比法

單位：倍

證券名稱(代號)	辛耘(3583)	中砂(1560)	精材(3374)	茂矽(2342)	上市半導體類	上櫃半導體類
107年3月	16.77	15.00	-	-	18.18	31.62
107年4月	13.93	14.66	-	-	17.62	29.61
107年5月	15.76	14.22	-	200.00	17.51	30.15
平均本益比	15.49	14.63	-	200.00	17.77	30.46

資料來源：臺灣證券交易所網站及中華民國證券櫃檯買賣中心網站

由上表得知，最近三個月採樣同業、上市半導體類及上櫃半導體類之平均本益比，排除茂矽公司及上櫃半導體類之平均本益比因偏離較多而暫不擬採用外，約在 14.63~17.77 倍之間，若以最近四季(106 年第二季至 107 年第一季)之稅後盈餘 150,462 仟元，及依擬上市掛牌股本 132,408 仟股推算每股稅後盈餘 1.14 元為基礎，計價價格區間約為 16.68~20.26 元。

(2) 股價淨值比法

單位：倍

證券名稱(代號)	辛耘(3583)	中砂(1560)	精材(3374)	茂矽(2342)	上市半導體類	上櫃半導體類
107年3月	2.40	2.71	4.09	2.67	3.13	3.42
107年4月	1.99	2.59	3.57	2.96	3.13	3.2
107年5月	2.23	2.51	4.50	4.33	2.99	3.49
平均股票淨值比	2.21	2.60	4.05	3.32	3.08	3.37

資料來源：臺灣證券交易所網站及中華民國證券櫃檯買賣中心網站

由上表可知，最近三個月採樣同業、上市半導體類及上櫃半導體類之平均股價淨值比，並排除精材公司之股價淨值比因偏離較多而暫不擬採用外，約在 2.21~3.37 倍之間，以該公司 107 年第一季經會計師查核簽證之財務報表之權益為 1,769,785 仟元，依擬上市掛牌股本 132,408 仟股計算之每股淨值 13.37 元計算，價格區間約為 29.55~45.06 元。惟因此種評價方式係以歷史成本為計算依據，限制及影響因素較多，易受經營期間長短及盈餘分配政策、股東權益內容結構等非獲利性之影響，且並未考量未來成長機會，故本證券承銷商不擬採用此方法。

2. 成本法

成本法近似重置成本的理論，所謂重置成本法，本指企業如要重製或重購相似資產所需花費之數額。以重置成本來估計資產之價值，即是以企業重製或重購相同獲利能力之資產所需花費之成本數額來估計其價值，且必須有相似且合理之資產價格可供參考，另外使用成本法的限制有下列 4 種：

- (1) 無法表達目前真正及外來的經濟貢獻值
- (2) 忽略了技術經濟壽命
- (3) 技術廢舊及變革對於其所造成的風險無法預測
- (4) 成本法中對於折舊項目及金額有量化的困難

由於上述種種限制，故國際上採成本法評估企業價值者並不多見，以下列出採樣同業與公司之比較：

單位：新台幣仟元；元

項目	總資產(A)	總負債(B)	權益(A-B)	股本	每股淨值	107年5月均價
公司別						
昇陽半導體	2,889,726	1,119,941	1,769,785	1,324,080	13.37	34.47
辛耘公司	3,375,417	1,065,715	2,309,702	811,390	28.47	60.25
中砂公司	5,585,430	1,363,504	4,221,926	1,410,000	29.94	75.17
精材公司	7,570,798	3,292,195	4,278,603	2,716,949	15.75	66.95
茂矽公司	2,669,563	1,363,845	1,305,718	1,131,423	11.54	40.85

資料來源：臺灣證券交易所網站、中華民國證券櫃檯買賣中心網站及福邦證券整理

註：採樣同業主要係以 107 年第一季合併報表為參考依據，該公司係以擬掛牌時股份總數 132,408 仟股計算。

由上表可知，該公司與採樣同業公司所計算出每股淨值與市場交易價格差異甚大，主要係成本法並未考量公司成長性，較常用於評估傳統產業類股或公營事業公司，因此本證券承銷商不擬採用此種方式作為承銷價格訂定之參考依據。

3. 收益法

收益法係認為企業價值應為未來營運可能創造利益流量之現值總和，惟在股價評價模型中，需推估公司未來數年之利益流量，然因所需之預測期間較長，假設參數眾多且無一致之標準，推估營收獲利資料之困難度提高，不確定性風險隨之而升，加深合理評估公司應有價值之難度，在考量公司及整體市場預估成長率及參酌 104~106 年度相關財務比率等計算之參考價格區間為 29.81~45.73 元。

綜上所述，本承銷商經考量各評價方法之優缺點、適用時機、市場慣用方式及該公司過去營運績效暨產業前景等因素，選擇

「本益比法」作為承銷價格之參考定價模式，主係目前市場上投資人對於獲利型公司之訂價多以本益比法為主要評價基礎，其最大優點在於簡單易懂，市場投資人認同度高，廣為獲利及營收成長型公司評價所採用，故以本益比法計算承銷價格之參考價格尚屬合理。

(二)發行公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形

茲就該公司及其子公司與採樣同業辛耘公司、中砂公司、精材公司及茂矽公司之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形說明如下：

1.財務狀況

單位：新台幣仟元；%

分析項目		年度 公司	104 年度	105 年度	106 年度	107 年第一季
財務 結構	負債占資產比率(%)	昇陽半導體	37.17	39.58	43.44	38.76
		辛耘公司	46.86	38.73	35.72	31.57
		中砂公司	25.90	24.34	23.63	24.41
		精材公司	31.31	39.47	46.31	43.49
		茂矽公司	62.78	64.01	51.41	51.09
		同業平均	39.27	40.45	註	註
	長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)	昇陽半導體	135.23	134.31	135.50	133.68
		辛耘公司	153.86	167.64	208.37	200.55
		中砂公司	149.20	143.10	154.16	161.47
		精材公司	105.56	117.81	125.31	128.04
		茂矽公司	193.39	221.79	448.62	463.55
		同業平均	177.94	174.83	註	註

資料來源：各公司經會計師查核簽證之財務報告、股東會年報及臺灣經濟新報(TEJ)資料庫，同業資料係依據財團法人金融聯合徵信中心之「中華民國台灣地區主要行業財務比率」中「電子零組件製造業」之財務比率

註：財團法人金融聯合徵信中心並未公布 106 年及 107 年第一季之「中華民國台灣地區主要行業財務比率」。

(1)負債占資產比率

該公司及其子公司 104~106 年度及 107 年第一季之負債占資產比率分別為 37.17%、39.58%、43.44%及 38.76%。105 年度該比率略微上升至 39.58%，主係該公司擴增晶圓薄化服務產線，持續添購機器設備及營運資金所需，增加銀行借款 235,703 仟元，另因業績成長而增加提列獎金及酬勞所致；106 年度該比率上升至 43.44%，主係晶圓薄化營收成長，持續擴充產線購置機器設備，故銀行借款增加 91,562 仟元，以及子公司增資尚未收足股款，產生預收股款 73,997 仟元所致；107 年第一季之負債比率降至 38.76%，主要係該公司 107 年度資本支出規劃多於下半年展開，尚未動用銀行借款，而 106 年底之長期借款陸續按月償還 110,995 千元，致負債比率較 106 年底下降。

與採樣同業及同業平均相較，該公司及其子公司 104~106 年度及 107 年第一季之負債占資產比率皆介於採樣公司及同業平均之間，尚無重大異常之情事。

(2)長期資金占不動產、廠房及設備比率

該公司及其子公司 104~106 年度及 107 年第一季之長期資金占不動產、廠房及設備比率分別為 135.23%、134.31%、135.50%及 133.68%，105 年度該公司為因應晶圓薄化代工服務營收成長，持續擴充產線而購置生產設備所致；106 年度因持續添購晶圓薄化之機器設備，使得不動產、廠房及設備淨額較為增加，惟因該公司之子公司於 106 年度辦理現金增資而預收股款所致，使得長期資金較 105 年度提升，致使 106 年度之長期資金占不動產、廠房及設備比率略微提高；107 年第一季位持續擴增晶圓薄化產能而購置機器設備，致長期資金占不動產、廠房及設備比率較 106 年度減少。該比率皆在 100%以上，顯示其長期資金尚足以支應不動產、廠房及設備之資金需求。

與採樣同業及同業平均表現相較，該公司及其子公司 104~106 年度及 107 年第一季之長期資金占不動產、廠房及設備比率皆介於採樣公司及同業平均之間，尚無重大異常之情事。

整體而言，該公司及其子公司 104~106 年度及 107 年第一季之財務結構尚屬穩健，其變化情形尚無重大異常情事。

2.獲利情形

單位：新台幣仟元；%

分析項目		年度 公司	104 年度	105 年度	106 年度	107 年第一季
獲利 能力	權益報酬率(%)	昇陽半導體	11.67	11.88	10.41	7.23
		辛耘公司	4.41	14.36	14.83	2.74
		中砂公司	15.28	14.10	18.70	15.74
		精材公司	2.79	(11.62)	(15.42)	(15.79)
		茂矽公司	(67.16)	(14.63)	(3.41)	5.09
		同業平均	12.20	12.30	註 2	註 2
	營業利益占實收資本額比率(%)	昇陽半導體	20.16	21.63	21.78	17.16
		辛耘公司	15.32	42.23	52.10	19.52
		中砂公司	48.69	44.74	62.79	58.92
		精材公司	8.73	(26.44)	(26.46)	(23.50)
		茂矽公司	(14.58)	1.39	5.58	12.67
		同業平均	註 1	註 1	註 1	註 1
	稅前純益占實收資本額比率(%)	昇陽半導體	19.80	20.21	19.25	14.55
		辛耘公司	14.61	44.78	51.13	8.80
		中砂公司	50.07	45.69	61.83	57.36
		精材公司	7.97	(27.48)	(27.98)	(25.23)
		茂矽公司	(26.52)	(2.66)	(3.18)	6.53
		同業平均	註 1	註 1	註 1	註 1

分析項目		年度	104 年度	105 年度	106 年度	107 年第一季
		公司				
純益率(%)	昇陽半導體	昇陽半導體	12.03	11.15	9.00	6.58
		辛耘公司	2.92	8.37	9.28	2.35
		中砂公司	14.42	12.95	16.19	13.21
		精材公司	3.01	(16.24)	(17.98)	(16.37)
		茂矽公司	(69.40)	(8.96)	(2.19)	3.80
		同業平均	12.20	10.70	註 2	註 2
	每股稅後盈餘(元)	昇陽半導體	1.57	1.63	1.43	0.32
		辛耘公司	1.06	3.60	4.05	0.19
		中砂公司	4.14	3.79	5.20	1.15
		精材公司	0.56	(2.36)	(2.71)	(0.63)
		茂矽公司	(2.65)	(0.33)	(0.32)	0.14
		同業平均	註 1	註 1	註 1	註 1

資料來源：各公司經會計師查核簽證之財務報告及股東會年報；財團法人金融聯合徵信中心之「中華民國台灣地區主要行業財務比率」中「電子零組件製造業」之財務比率

註 1：「中華民國台灣地區主要行業財務比率」未提供同業平均之營業利益占實收資本額比率、稅前純益占實收資本額比率及每股盈餘。

註 2：財團法人金融聯合徵信中心並未公布 106 年及 107 年第一季之「中華民國台灣地區主要行業財務比率」。

(1) 權益報酬率

該公司及其子公司 104~106 年度及 107 年第一季之權益報酬率分別為 11.67%、11.88%、10.41%及 7.23%。105 年度因稅後淨利增加 4.25%，然平均權益增加幅度僅 2.40%，故使權益報酬率略為提升至 11.88%；106 年度因迴轉遞延所得稅資產致所得稅費用增加，使得稅後淨利下降，致權益報酬率下降至 10.41%；107 年第一季該公司為擴大營運規模而持續購置機器設備，造成固定成本增加，且陸續聘僱員工以及估列相關上市費用而致營業費用增加，使得稅後淨利下降，致權益報酬率下降至 7.23%。

與採樣同業及同業平均比較，該公司及其子公司 104~106 年度及 107 年第一季權益報酬率皆介於採樣同業及同業平均之間，尚無重大異常之情事。

(2) 營業利益占實收資本比率、稅前純益占實收資本額比率

該公司及其子公司 104~106 年度及 107 年第一季之營業利益占實收資本額比率分別為 20.16%、21.63%、21.78%及 17.16%，稅前純益占實收資本額比率分別為 19.80%、20.21%、19.25%及 14.55%。105 年度營業利益及稅前純益占實收資本額比率分別提升為 21.63%及 20.21%，主係晶圓薄化及微機電代工服務之產能擴充效益顯現，營收貢獻及比重增加，在營業毛利率及費用率控管得宜之情況下，營業利益及稅前純益獲得提升所致；106 年度營業利益占實收資本額比率微幅上升至 21.78%，主係晶圓薄化之業績及毛利持續獲得提升，在營業費用率獲得控制下，營業利益係隨營業毛利增加而成長，然稅前純益占實收資本比率下降至 19.25%，主係 106 年度美金因國際政經因素貶值幅度較高，致外幣兌換損失增加，使得稅前純益減少所致；107 年第一季該公司持續購置機器設備而造成固定成本增加，且陸續聘僱員工以及估列相關上市費用而致營業費用增加，使得營業利益及稅前純益皆較 106 年度下降，致營業利益及稅前純益占實收資本額比率分別下降至 17.16%及 14.55%。

與採樣同業比較，該公司及其子公司 104~106 年度及 107 年第一季營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率皆介於採樣同業之間，顯示該公司獲利能力尚屬良好，尚無重大異常之情事。

(3) 純益率及每股稅後盈餘

該公司及其子公司 104~106 年度及 107 年第一季之純益率分別為 12.03%、11.15%及 9.00%及 6.58%，每股稅後盈餘分別為 1.57 元、1.63 元、1.43 元及 0.32 元。105 年度因美金匯率呈現貶值情形，該公司產生 7,254 仟元之淨外幣兌換損失，稅後淨利成長幅度小於銷貨淨額，以致純益率略為下降至 11.15%，惟 105 年度因景氣回升及公司營運策略轉換成果持續顯現，營業收入及毛利皆成長，加上營業費用率控管得宜之情況下，每股盈餘隨稅後純益之金額增加而成長，105 年每股稅後盈餘略為上升至 1.63 元；106 年度純益率下降至 9.00%，且每股稅後盈餘下降至 1.43 元，主係因美金匯率貶值幅度大，認列之兌換損失金額較 105 年度增加 13,213 仟元，且所得稅費用因迴轉存貨呆滯及跌價損失所產生之遞延所得稅資產而增加，使得純益率及每股稅後盈餘均有所下滑；107 年第一季純益率及每股稅後盈餘分別下降至 6.58%及 0.32 元，主係該公司擴大營運規模而持續購置機器設備，造成固定成本增加，使營業毛利較為減少，且陸續聘僱員工以及估列相關上市費用而致營業費用增加所致。

與採樣同業及同業平均比較，該公司及其子公司 104~106 年度及 107 年第一季純益率及每股盈餘均介於採樣同業及同業平均間，尚無重大異常之情事。

整體而言，該公司及其子公司 104~106 年度及 107 年第一季之獲利能力尚屬良好，其變化應無重大異常情事。

3. 本益比

請詳前述二、(一)、1、(1)之評估說明。

(三) 所議定之承銷價若參考財務專家意見或鑑價機構之鑑價報告者，應說明該專家意見或鑑價報告內容及結論

本次承銷價格之議定並無參考專家意見或鑑價機構之鑑價報告，故不適用。

(四) 發行公司於興櫃市場掛牌之最近一個月平均股價及成交量資料

月份	平均股價(元)	成交量(股)
107/5/26~107/6/25	38.44	14,092,315

資料來源：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心網站

該公司最近一個月(107/5/26~107/6/25)之股價介於35.59~42.11元間，尚無價格異常波動之情事，另經查詢證券櫃檯買賣中心網站「興櫃公布注意股票資訊」及「興櫃處置股票資訊」，該公司自申請上市日迄今，非為「興櫃股票公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點」第4條規定公告為「興櫃公布注意股票」，且無「興櫃股票買賣辦法」第11條之1規定暫停交易(啟動興櫃股票市場冷卻機制)之情事。

(五) 證券承銷商就其與發行公司所共同議定承銷價格合理性之評估意見

經參考採樣同業及上市半導體類股最近三個月之本益比及該公司最近一個月興櫃市場之平均成交價格，並參酌該公司之所處產

業、經營績效、發行市場環境及同業之市場狀況，以及考量初次上市股票流動性風險貼水等因素後，由本證券承銷商與該公司共同議定之。

該公司初次上市股票係採競價拍賣之承銷方式，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 8 條規定，於向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前有成交之三十個營業日其成交均價簡單算術平均數之七成為上限，作為最低承銷價格(競價拍賣底標)。經設算該公司 107 年 6 月 14 日前有成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數為 35.71 元，並以不高於該簡單算數平均數之七成，與該公司共同議定最低承銷價格為新台幣 20.50 元(競價拍賣底價)，並依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格新台幣 33.56 元為之，惟均價高過於最低承銷價格之 1.2 倍上限(即新台幣 24.6 元)，故承銷價格定為每股新台幣 24.6 元溢價發行，應屬合理。

發行公司：昇陽國際半導體股份有限公司	代表人：楊敏聰
主辦承銷商：富邦證券股份有限公司	代表人：林火燈
協辦承銷商：元大證券股份有限公司	代表人：賀鳴珩
協辦承銷商：群益金鼎證券股份有限公司	代表人：王濬智
協辦承銷商：玉山綜合證券股份有限公司	代表人：林晉輝
協辦承銷商：臺灣土地銀行股份有限公司	代表人：凌忠嫻
協辦承銷商：富邦綜合證券股份有限公司	代表人：史綱

【附件二】律師法律意見書

昇陽國際半導體股份有限公司本次為募集與發行普通股 15,580,000 股，每股面額新台幣 10 元，總金額為新台幣 155,800,000 元，向臺灣證券交易所股份有限公司提出申報。經本律師採取必要審核程序，包括實地瞭解，與公司董事、經理人及相關人員面談或舉行會議，蒐集、整理、查證公司議事錄、重要契約及其他相關文件、資料，並參酌相關專家之意見等。特依「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定，出具本律師法律意見書。

依本律師意見，昇陽國際半導體股份有限公司本次向臺灣證券交易所股份有限公司提出之法律事項檢查表所載事項，並未發現有違反法令致影響有價證券募集與發行之情事。

禾同國際法律事務所

蕭富山律師

【附件三】證券承銷商評估報告總結意見

昇陽國際半導體股份有限公司（以下簡稱昇陽半導體或該公司）本次為辦理初次上市前現金增資發行普通股 15,580 仟股，每股面額新台幣 10 元，合計發行總面額為新台幣 155,800 仟元整，依法向臺灣證券交易所股份有限公司提出申報。業經本承銷商採用必要之輔導及評估程序，包括實地了解該公司之營運狀況，與該公司董事、經理人及其他相關人員面談或舉行會議，蒐集、整理、查證及比較分析相關資料等，予以審慎評估。特依金融監督管理委員會「發行人募集與發行有價證券處理準則」及中華民國證券商業同業公會「發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告應行記載事項要點」及「證券承銷商受託辦理發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告之評估查核程序」規定，出具本承銷商總結意見。

依本承銷商之意見，昇陽半導體本次募集與發行有價證券符合「發行人募集與發行有價證券處理準則」及相關法令之規定，暨其計畫具可行性及必要性，其資金用途、進度及預計可能產生效益亦具合理性。

富邦證券股份有限公司 負責人：林火燈
部門主管：林瑛明